

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表
(2024年7月15日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 ()
参与单位名称	银河基金、东吴证券、华西证券、远桥资产、汐泰投资
活动时间	2024年7月9日
活动地点	反路演
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的经营情况。</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、公司对 NOR Flash 这个产品是怎样的市场规划？ 答：公司目前量产的以 48nm 中大容量 1.8V 低功耗的产品为主，主要针对可穿戴、CAT1 模块以及功能手机等应用领域。公司正在积极拓展 55nm NOR Flash 的产品线，未来逐步向工业、医疗、车规等高可靠性需求的客户积极进行产品导入工作。</p> <p>2、公司的车规产品目前进度如何？ 答：公司 SLC NAND Flash、NOR Flash 以及 MCP 均有产品通过 AEC-Q100 测试，将适用于要求更为严苛的车规级应用环境。公司目前已有产品向境外知名的一级汽车供应商（Tier1）销售，公司也正在积极进行客户端的产品导入工作，坚持从工业级向车规级方向发展。</p> <p>3、公司对在研发费用方面增长是如何进行考量的？</p>

	<p>答：研发实力作为公司立足于市场且维持公司持续发展的动能，我们对公司的研发实力非常重视，随着研发项目的新增和现有项目的展开，公司将持续进行相应水平的研发投入。</p> <p>4、相比 38nm 制程的 SLC NAND 产品，24nm 以及 28nm 制程有哪些优势？</p> <p>答：主要有三个方面的区别。第一是成本，更先进的制程和更高的良率将带来成本的优化。第二是容量，制程越先进，同样大小的颗粒可做到的容量将越大，可应用的领域会更多。第三是可靠性，不同制程的产品的可靠性水平会根据制程的成熟度有所区别，我们会根据不同领域客户需求提供相应的产品。</p> <p>5、公司对于 Wi-Fi7 产品研发如何考虑，目前进度如何？</p> <p>答：公司基于战略规划考虑与业务发展需要，于今年新增投入研发力量，从事 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发、设计与销售，凭借多年来在行业内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，进一步丰富公司产品品类，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，拓展行业应用领域，优化业务布局，以期为客户提供更多样化的芯片解决方案。研发团队主要成员具有国内外通信芯片大厂的研发经验，致力于打造本土化的中高端的 Wi-Fi 7 通信芯片，目前团队正在积极进行产品研发工作。目前国内的厂商将更多精力放在了 Wi-Fi 6 上，关于 Wi-Fi 7 的开发仍处于早期阶段。随着 Wi-Fi 7 标准的制定，未来在元宇宙、自动驾驶、AIOT 等新概念、新应用的推动下，具有良好的发展前景。</p>
日期	2024 年 7 月 15 日